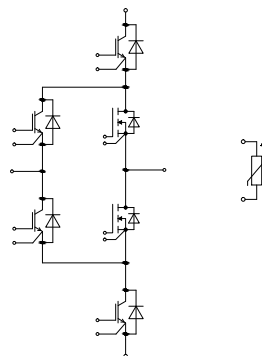
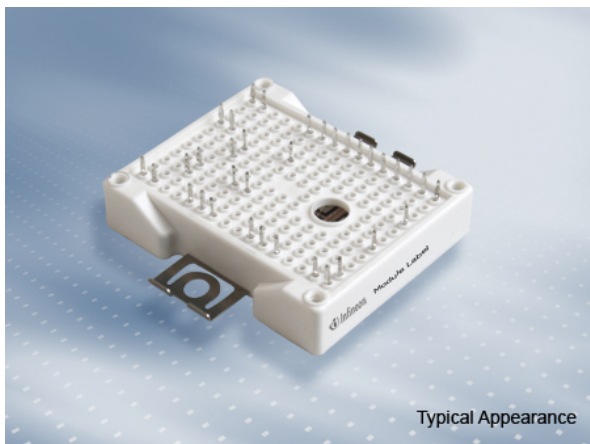


EasyPACK™ Modul mit CoolSiC™ Trench MOSFET und PressFIT / NTC
EasyPACK™ module with CoolSiC™ Trench MOSFET and PressFIT / NTC

Vorläufige Daten / Preliminary Data



$V_{DSS} = 1200V$

$I_{D\ nom} = 100A / I_{DRM} = 200A$

Potentielle Anwendungen

- 3-Level-Applikationen
- Anwendungen mit hohen Schaltfrequenzen
- Solar Anwendungen

Elektrische Eigenschaften

- Erhöhte Zwischenkreisspannung
- Hohe Stromdichte
- Niedrige Schaltverluste

Mechanische Eigenschaften

- Integrierter NTC Temperatur Sensor
- PressFIT Verbindungstechnik
- Robuste Montage durch integrierte Befestigungsklammern

Potential Applications

- 3-level-applications
- High Frequency Switching application
- Solar applications

Electrical Features

- Increased DC-link voltage
- High current density
- Low switching losses

Mechanical Features

- Integrated NTC temperature sensor
- PressFIT contact technology
- Rugged mounting due to integrated mounting clamps

Module Label Code

Barcode Code 128



DMX - Code



Content of the Code

Content of the Code	Digit
Module Serial Number	1 - 5
Module Material Number	6 - 11
Production Order Number	12 - 19
Datecode (Production Year)	20 - 21
Datecode (Production Week)	22 - 23

Vorläufige Daten Preliminary Data

MOSFET / MOSFET

Höchstzulässige Werte / Maximum Rated Values

Drain-Source-Spannung Drain-source voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	V_{DSS}	1200	V
Drain-Gleichstrom DC drain current	$T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}, V_{GS} = 15\text{ V}$ $T_H = 5^{\circ}\text{C}$	$I_{D\text{ nom}}$	100	A
Gepulster Drainstrom Pulsed drain current	verifiziert durch Design, t_p limitiert durch $T_{vj\text{ max}}$ verified by design, t_p limited by $T_{vj\text{ max}}$	$I_{D\text{ pulse}}$	200	A
Gate-Source Spannung Gate-source voltage		V_{GSS}	-10 / 20	V

Charakteristische Werte / Characteristic Values

				min.	typ.	max.	
Einschaltwiderstand Drain-source on resistance	$I_D = 100\text{ A}$ $V_{GS} = 15\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$R_{DS\text{ on}}$		11,3 14,8 16,5		mΩ
Gate-Schwellenspannung Gate threshold voltage	$I_D = 40,0\text{ mA}, V_{DS} = V_{GS}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ (tested after 1ms pulse at $V_{GS} = +20\text{ V}$)		$V_{GS(th)}$	3,45	4,50	5,55	V
Gesamt Gateladung Total gate charge	$V_{GS} = -5\text{ V} / 15\text{ V}, V_{DS} = 800\text{ V}$		Q_G		0,248		μC
Interner Gatewiderstand Internal gate resistor	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		R_{Gint}		1,0		Ω
Eingangskapazität Input capacitance	$f = 1\text{ MHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_{DS} = 800\text{ V}, V_{GS} = 0\text{ V}, V_{AC} = 25\text{ mV}$		C_{iss}		7,36		nF
Ausgangskapazität Output capacitance	$f = 1\text{ MHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_{DS} = 800\text{ V}, V_{GS} = 0\text{ V}, V_{AC} = 25\text{ mV}$		C_{oss}		0,44		nF
Rückwirkungskapazität Reverse transfer capacitance	$f = 1\text{ MHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_{DS} = 800\text{ V}, V_{GS} = 0\text{ V}, V_{AC} = 25\text{ mV}$		C_{rss}		0,056		nF
C_{oss} Speicherenergie C_{oss} stored energy	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $V_{DS} = 800\text{ V}, V_{GS} = -5\text{ V} / 15\text{ V}$		E_{oss}		176		μJ
Drain-Source-Reststrom Zero gate voltage drain current	$V_{DS} = 1200\text{ V}, V_{GS} = -5\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	I_{DSS}		0,40	380	μA
Gate-Source-Reststrom Gate-source leakage current	$V_{DS} = 0\text{ V}$ $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	$V_{GS} = 20\text{ V}$ $V_{GS} = -10\text{ V}$	I_{GSS}			400	nA
Einschaltverzögerungszeit, induktive Last Turn on delay time, inductive load	$I_D = 100\text{ A}, V_{DS} = 600\text{ V}$ $V_{GS} = -5\text{ V} / 15\text{ V}$ $R_{Gon} = 4,70\text{ Ω}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$t_{d\text{ on}}$		26,7 25,0 23,8		ns
Anstiegszeit, induktive Last Rise time, inductive load	$I_D = 100\text{ A}, V_{DS} = 600\text{ V}$ $V_{GS} = -5\text{ V} / 15\text{ V}$ $R_{Gon} = 4,70\text{ Ω}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	t_r		23,4 22,9 21,9		ns
Abschaltverzögerungszeit, induktive Last Turn off delay time, inductive load	$I_D = 100\text{ A}, V_{DS} = 600\text{ V}$ $V_{GS} = -5\text{ V} / 15\text{ V}$ $R_{Goff} = 4,70\text{ Ω}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$t_{d\text{ off}}$		82,9 85,7 86,3		ns
Fallzeit, induktive Last Fall time, inductive load	$I_D = 100\text{ A}, V_{DS} = 600\text{ V}$ $V_{GS} = -5\text{ V} / 15\text{ V}$ $R_{Goff} = 4,70\text{ Ω}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	t_f		18,5 20,8 21,7		ns
Einschaltverlustenergie pro Puls Turn-on energy loss per pulse	$I_D = 100\text{ A}, V_{DS} = 600\text{ V}, L_{\sigma} = 35\text{ nH}$ $di/dt = 5,00\text{ kA}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$) $V_{GS} = -5\text{ V} / 15\text{ V}, R_{Gon} = 4,70\text{ Ω}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	E_{on}		1,57 1,59 1,62		mJ
Abschaltverlustenergie pro Puls Turn-off energy loss per pulse	$I_D = 100\text{ A}, V_{DS} = 600\text{ V}, L_{\sigma} = 35\text{ nH}$ $du/dt = 23,0\text{ kV}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$) $V_{GS} = -5\text{ V} / 15\text{ V}, R_{Goff} = 4,70\text{ Ω}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	E_{off}		1,33 1,42 1,44		mJ
Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper Thermal resistance, junction to heatsink	pro MOSFET / per MOSFET		R_{thJH}		0,660		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb Temperature under switching conditions			$T_{vj\text{ op}}$	-40		150	°C

Body Diode / Body diode

Höchstzulässige Werte / Maximum Rated Values

Body Diode-Gleichstrom DC body diode forward current	$T_{vj} = 175^{\circ}\text{C}, V_{GS} = -5\text{ V}$	$T_H = 5^{\circ}\text{C}$	I_{SD}	32	A
---	--	---------------------------	----------	----	---

Charakteristische Werte / Characteristic Values

				min.	typ.	max.	
Durchlassspannung Forward voltage	$I_{SD} = 100\text{ A}, V_{GS} = -5\text{ V}$ $I_{SD} = 100\text{ A}, V_{GS} = -5\text{ V}$ $I_{SD} = 100\text{ A}, V_{GS} = -5\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	V_{SD}		4,60 4,35 4,30	5,65	V

Vorläufige Daten Preliminary Data

IGBT,3-Level / IGBT,3-Level

Höchstzulässige Werte / Maximum Rated Values

Kollektor-Emitter-Sperrspannung Collector-emitter voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	V_{CES}	1200	V
Implementierter Kollektor-Strom Implemented collector current		I_{CN}	100	A
Kollektor-Dauergleichstrom Continuous DC collector current	$T_H = 65^{\circ}\text{C}, T_{vj\max} = 175^{\circ}\text{C}$	I_{CDC}	65	A
Periodischer Kollektor-Spitzenstrom Repetitive peak collector current	$t_P = 1\text{ ms}$	I_{CRM}	200	A
Gate-Emitter-Spitzenspannung Gate-emitter peak voltage		V_{GES}	+/-20	V

Charakteristische Werte / Characteristic Values

			min.	typ.	max.	
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung Collector-emitter saturation voltage	$I_C = 100\text{ A}$ $V_{GE} = 15\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	$V_{CE\text{ sat}}$	1,75 2,05 2,10	2,10	V V V
Gate-Schwellenspannung Gate threshold voltage	$I_C = 4,00\text{ mA}, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		V_{Geth}	5,05	5,80	6,45 V
Gateladung Gate charge	$V_{GE} = -15\text{ V} / 15\text{ V}$		Q_G	0,80		μC
Interner Gatewiderstand Internal gate resistor	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		R_{Gint}	0,0		Ω
Eingangskapazität Input capacitance	$f = 1000\text{ kHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$		C_{ies}	6,30		nF
Rückwirkungskapazität Reverse transfer capacitance	$f = 1000\text{ kHz}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$		C_{res}	0,27		nF
Kollektor-Emitter-Reststrom Collector-emitter cut-off current	$V_{CE} = 1200\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		I_{CES}		0,04	mA
Gate-Emitter-Reststrom Gate-emitter leakage current	$V_{CE} = 0\text{ V}, V_{GE} = 20\text{ V}, T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$		I_{GES}		100	nA
Einschaltverzögerungszeit, induktive Last Turn-on delay time, inductive load	$I_C = 100\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}$ $V_{GE} = -15\text{ V} / 15\text{ V}$ $R_{Gon} = 1,6\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	t_{don}	0,013 0,014 0,014		μs μs μs
Anstiegszeit, induktive Last Rise time, inductive load	$I_C = 100\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}$ $V_{GE} = -15\text{ V} / 15\text{ V}$ $R_{Gon} = 1,6\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	t_r	0,009 0,01 0,01		μs μs μs
Abschaltverzögerungszeit, induktive Last Turn-off delay time, inductive load	$I_C = 100\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}$ $V_{GE} = -15\text{ V} / 15\text{ V}$ $R_{Goff} = 1,6\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	t_{doff}	0,196 0,287 0,306		μs μs μs
Fallzeit, induktive Last Fall time, inductive load	$I_C = 100\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}$ $V_{GE} = -15\text{ V} / 15\text{ V}$ $R_{Goff} = 1,6\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	t_f	0,138 0,212 0,253		μs μs μs
Einschaltverlustenergie pro Puls Turn-on energy loss per pulse	$I_C = 100\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}, L\sigma = 35\text{ nH}$ $di/dt = 7800\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150^{\circ}\text{C})$ $V_{GE} = -15\text{ V} / 15\text{ V}, R_{Gon} = 1,6\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	E_{on}	1,94 3,05 3,34		mJ mJ mJ
Abschaltverlustenergie pro Puls Turn-off energy loss per pulse	$I_C = 100\text{ A}, V_{CE} = 600\text{ V}, L\sigma = 35\text{ nH}$ $du/dt = 3200\text{ V}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150^{\circ}\text{C})$ $V_{GE} = -15\text{ V} / 15\text{ V}, R_{Goff} = 1,6\ \Omega$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	E_{off}	5,47 9,12 10,4		mJ mJ mJ
Kurzschlußverhalten SC data	$V_{GE} \leq 15\text{ V}, V_{CC} = 800\text{ V}$ $V_{CEmax} = V_{CES} - L_{sCE} \cdot di/dt$ $t_P \leq 10\ \mu\text{s}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$		I_{SC}	400		A
Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper Thermal resistance, junction to heatsink	pro IGBT / per IGBT		R_{thJH}	0,655		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb Temperature under switching conditions			$T_{vj\text{ op}}$	-40	150	$^{\circ}\text{C}$

Vorläufige Daten Preliminary Data

Diode, 3-Level / Diode, 3-Level

Höchstzulässige Werte / Maximum Rated Values

Periodische Spitzensperrespannung Repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$	V_{RRM}	1200	V
Dauergleichstrom Continuous DC forward current		I_F	50	A
Periodischer Spitzenstrom Repetitive peak forward current	$t_P = 1\text{ ms}$	I_{FRM}	100	A
Grenzlastintegral I^2t - value	$V_R = 0\text{ V}, t_P = 10\text{ ms}, T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $V_R = 0\text{ V}, t_P = 10\text{ ms}, T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	I^2t	370 340	A^2s A^2s

Charakteristische Werte / Characteristic Values

			min.	typ.	max.	
Durchlassspannung Forward voltage	$I_F = 50\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$ $I_F = 50\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$ $I_F = 50\text{ A}, V_{GE} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 125^{\circ}\text{C}$ $T_{vj} = 150^{\circ}\text{C}$	V_F		1,75 1,75 1,75	2,15 V V V
Wärmewiderstand, Chip bis Kühlkörper Thermal resistance, junction to heatsink	pro Diode / per diode	R_{thJH}		1,17		K/W
Temperatur im Schaltbetrieb Temperature under switching conditions		$T_{vj\text{ op}}$	-40		150	$^{\circ}\text{C}$

Modul / Module

Isolations-Prüfspannung Isolation test voltage	RMS, $f = 50\text{ Hz}, t = 1\text{ min.}$	V_{ISOL}	3,0			kV
Innere Isolation Internal isolation	Basisisolierung (Schutzklasse 1, EN61140) basic insulation (class 1, IEC 61140)			Al_2O_3		
Kriechstrecke Creepage distance	Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal					mm
Luftstrecke Clearance	Kontakt - Kühlkörper / terminal to heatsink Kontakt - Kontakt / terminal to terminal			10,0 5,0		mm
Vergleichszahl der Kriechwegbildung Comperative tracking index		CTI		> 200		
Relativer Temperaturindex (elektr.) RTI Elec.	Gehäuse housing	RTI		140		$^{\circ}\text{C}$
			min.	typ.	max.	
Modulstreuinduktivität Stray inductance module		L_{sCE}		12		nH
Lagertemperatur Storage temperature		T_{stg}	-40		125	$^{\circ}\text{C}$
Anpresskraft für mech. Bef. pro Feder mounting force per clamp		F	20	-	50	N
Gewicht Weight		G		24		g

The current under continuous operation is limited to 25 A rms per connector pin.

Important note: The selection of positive and negative gate-source voltages impacts the long-term behavior of the device. The design guidelines described in Application Note AN 2018-09 must be considered to ensure sound operation of the device over the planned lifetime.

Vorläufige Daten Preliminary Data

NTC-Widerstand / NTC-Thermistor

Charakteristische Werte / Characteristic Values

			min.	typ.	max.	
Nennwiderstand Rated resistance	$T_{NTC} = 25^{\circ}\text{C}$	R_{25}		5,00		k Ω
Abweichung von R100 Deviation of R100	$T_{NTC} = 100^{\circ}\text{C}, R_{100} = 493 \Omega$	$\Delta R/R$	-5		5	%
Verlustleistung Power dissipation	$T_{NTC} = 25^{\circ}\text{C}$	P_{25}			20,0	mW
B-Wert B-value	$R_2 = R_{25} \exp [B_{25/50}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$	$B_{25/50}$		3375		K
B-Wert B-value	$R_2 = R_{25} \exp [B_{25/80}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$	$B_{25/80}$		3411		K
B-Wert B-value	$R_2 = R_{25} \exp [B_{25/100}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$	$B_{25/100}$		3433		K

Angaben gemäß gültiger Application Note.

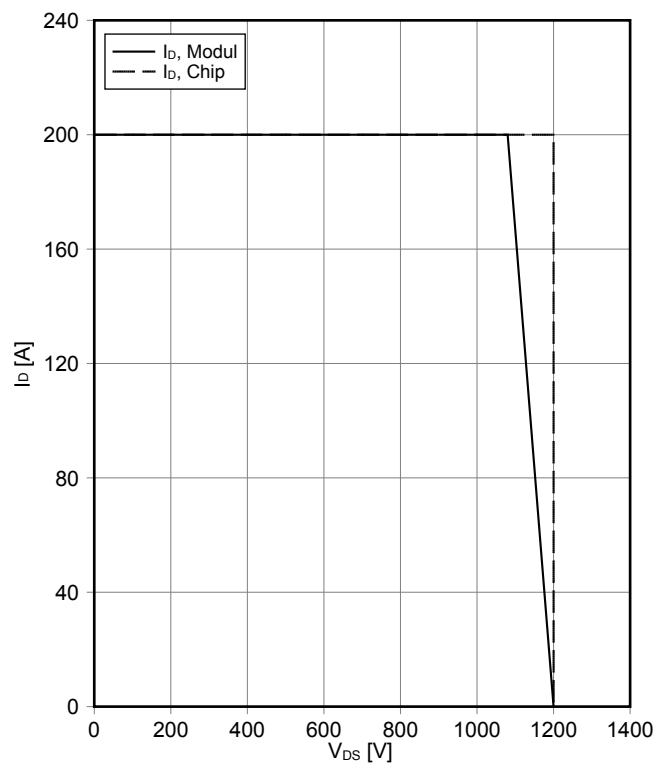
Specification according to the valid application note.

Vorläufige Daten Preliminary Data

Sicherer Rückwärts-Arbeitsbereich MOSFET (RBSOA) reverse bias safe operating area MOSFET (RBSOA)

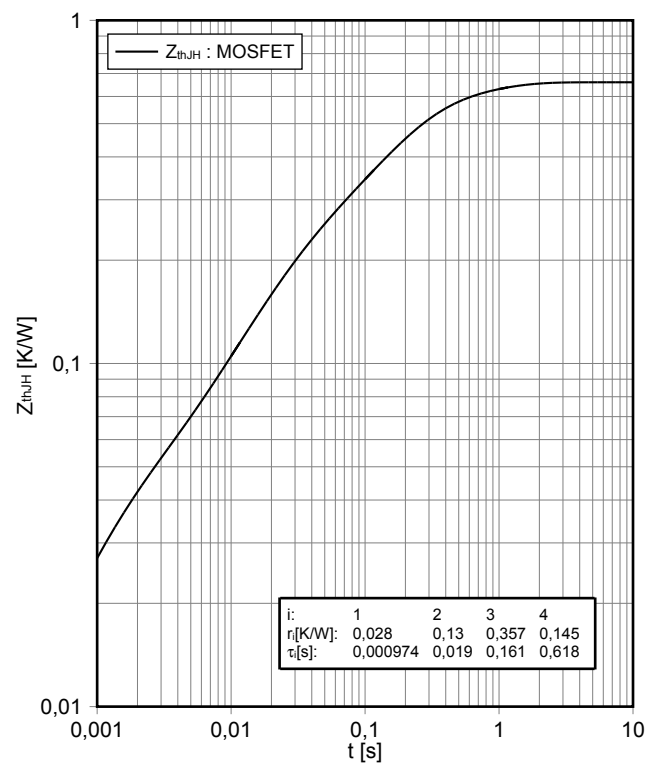
$I_D = f(V_{DS})$

$V_{GS} = -5 \text{ V} / 15 \text{ V}$, $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$, $R_G = 4,7 \ \Omega$



Transienter Wärmewiderstand MOSFET transient thermal impedance MOSFET

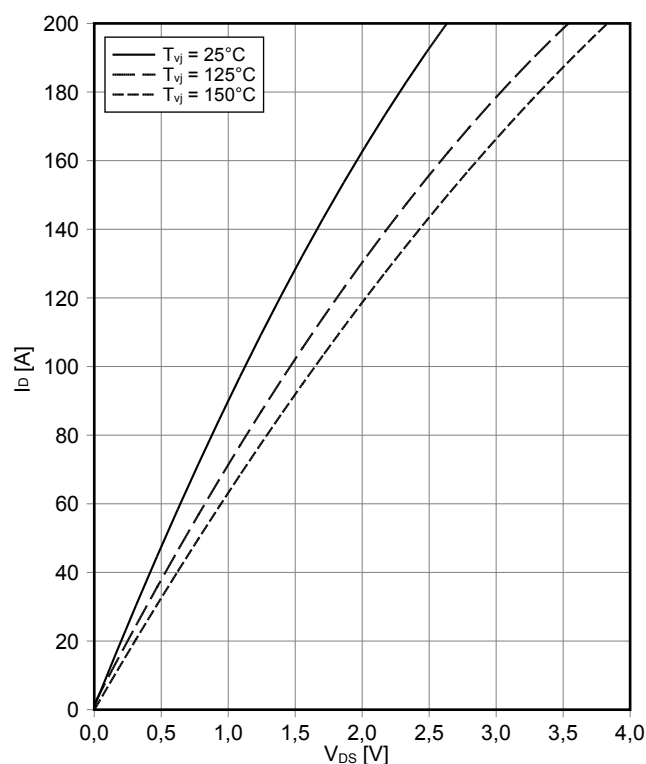
$Z_{thJH} = f(t)$



Ausgangskennlinie MOSFET (typisch) output characteristic MOSFET (typical)

$I_D = f(V_{DS})$

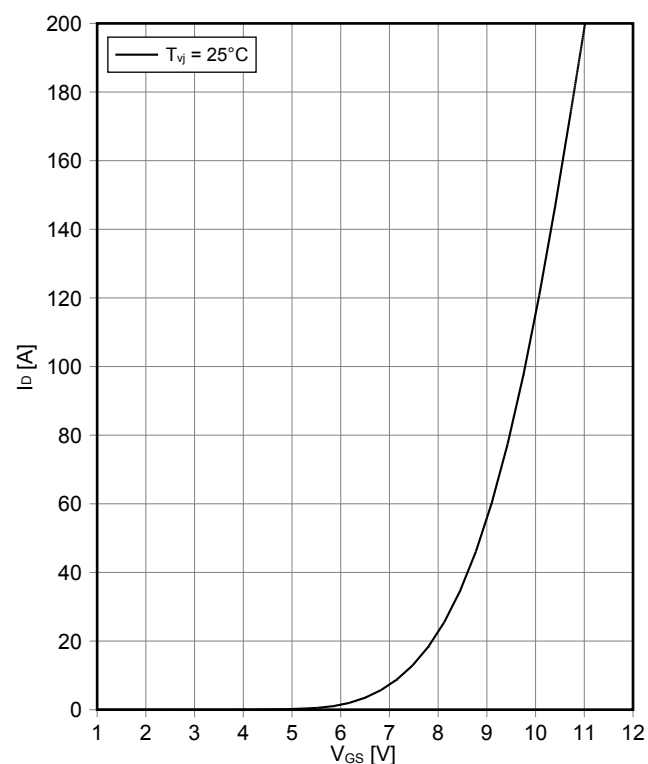
$V_{GS} = 15 \text{ V}$



Übertragungscharakteristik MOSFET (typisch) transfer characteristic MOSFET (typical)

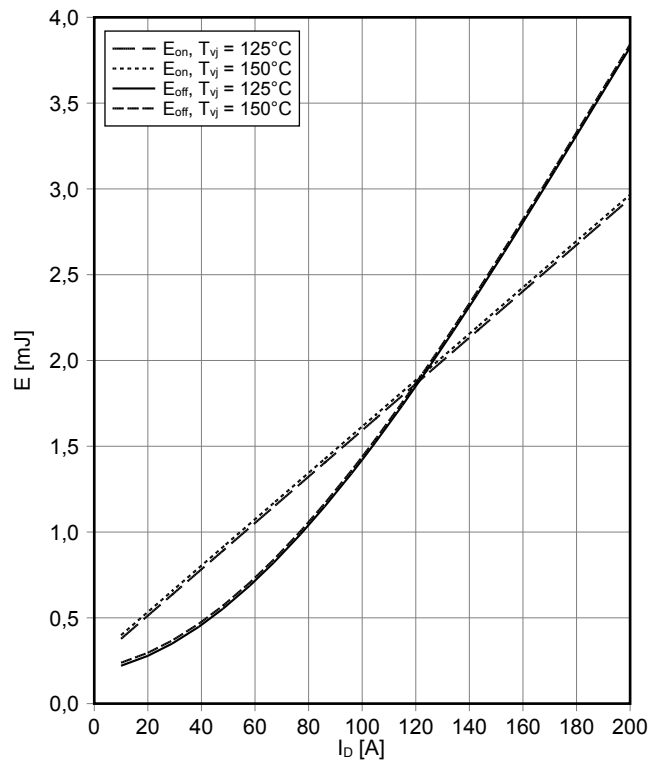
$I_D = f(V_{GS})$

$V_{DS} = 20 \text{ V}$

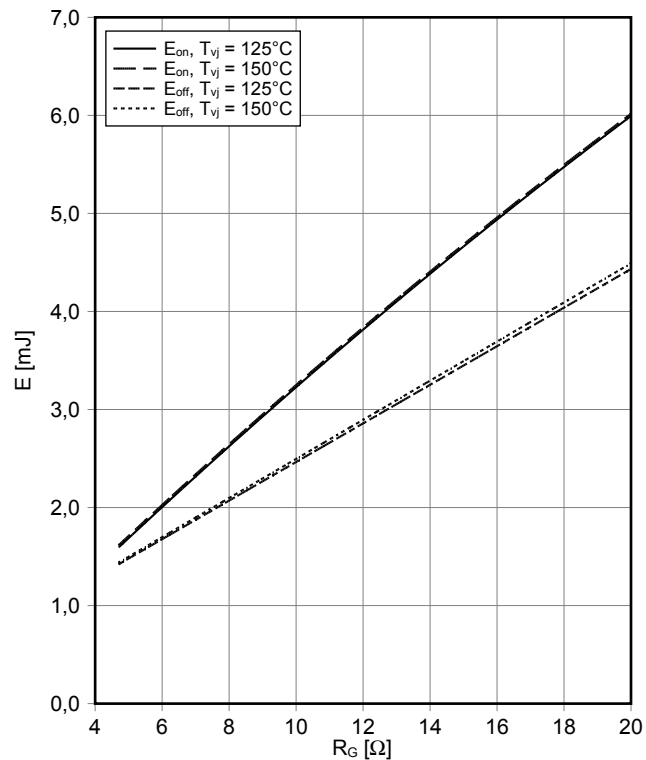


Vorläufige Daten Preliminary Data

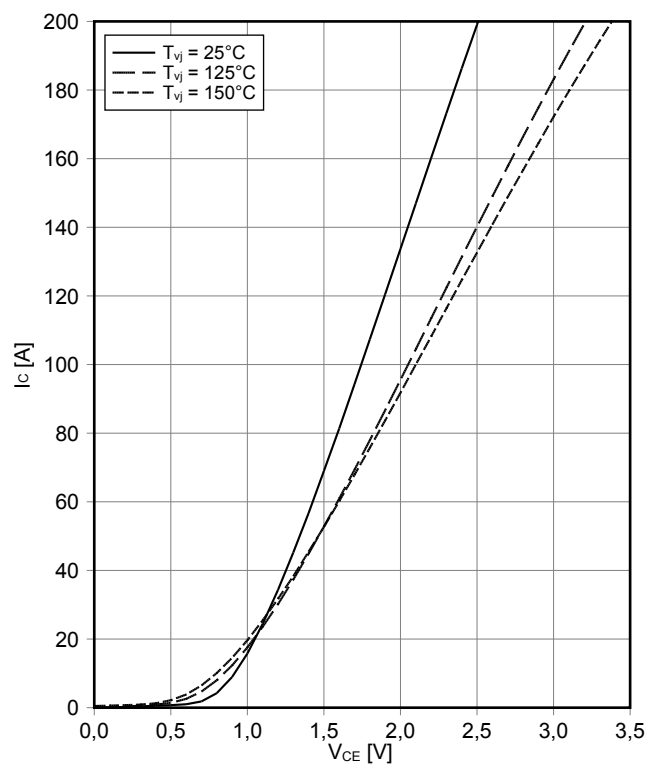
Schaltverluste MOSFET (typisch) switching losses MOSFET (typical)

 $E_{on} = f(I_D), E_{off} = f(I_D)$
 $V_{GS} = -5 \text{ V} / 15 \text{ V}, R_{Gon} = 4,7 \text{ } \Omega, R_{Goff} = 4,7 \text{ } \Omega, V_{DS} = 600 \text{ V}$


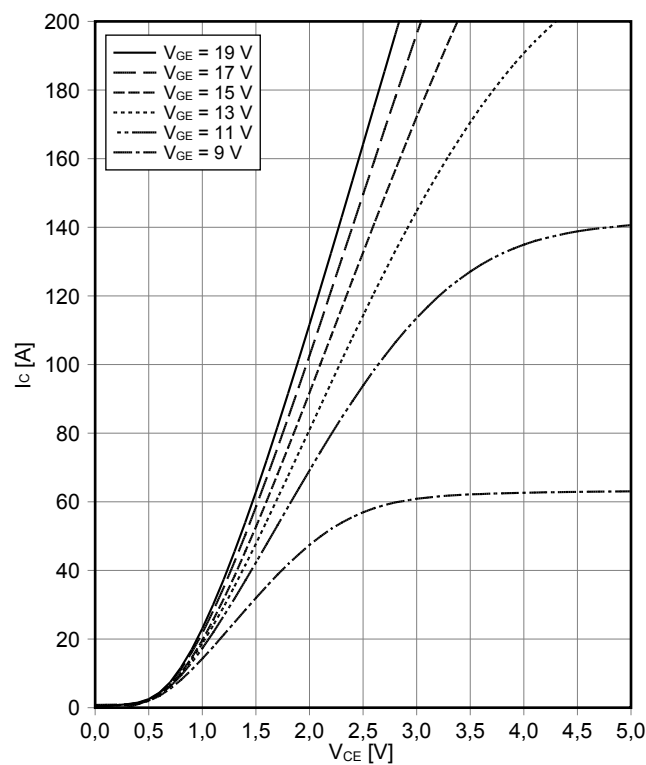
Schaltverluste MOSFET (typisch) switching losses MOSFET (typical)

 $E_{on} = f(R_G), E_{off} = f(R_G)$
 $V_{GS} = -5 \text{ V} / 15 \text{ V}, I_D = 100 \text{ A}, V_{DS} = 600 \text{ V}$


Ausgangskennlinie IGBT,3-Level (typisch) output characteristic IGBT,3-Level (typical)

 $I_C = f(V_{CE})$
 $V_{GE} = 15 \text{ V}$


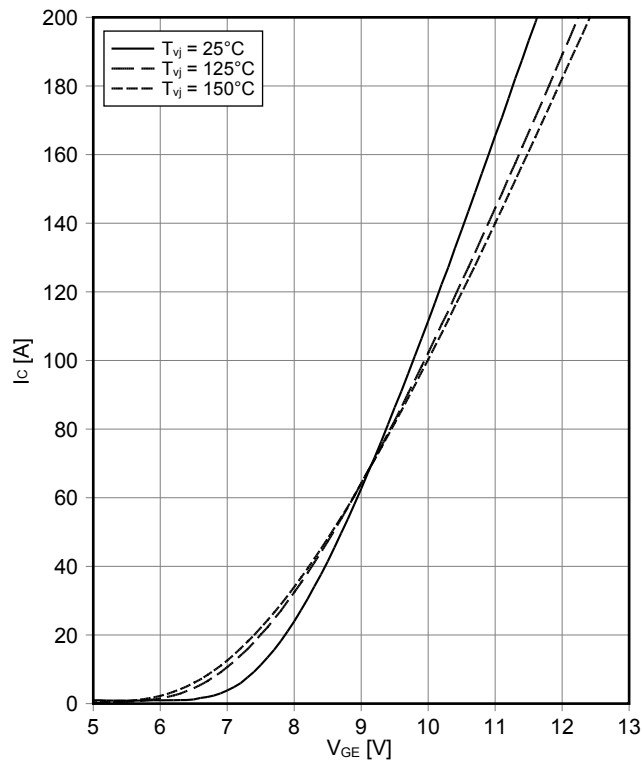
Ausgangskennlinienfeld IGBT,3-Level (typisch) output characteristic IGBT,3-Level (typical)

 $I_C = f(V_{CE})$
 $T_{vj} = 150^\circ\text{C}$


Vorläufige Daten Preliminary Data

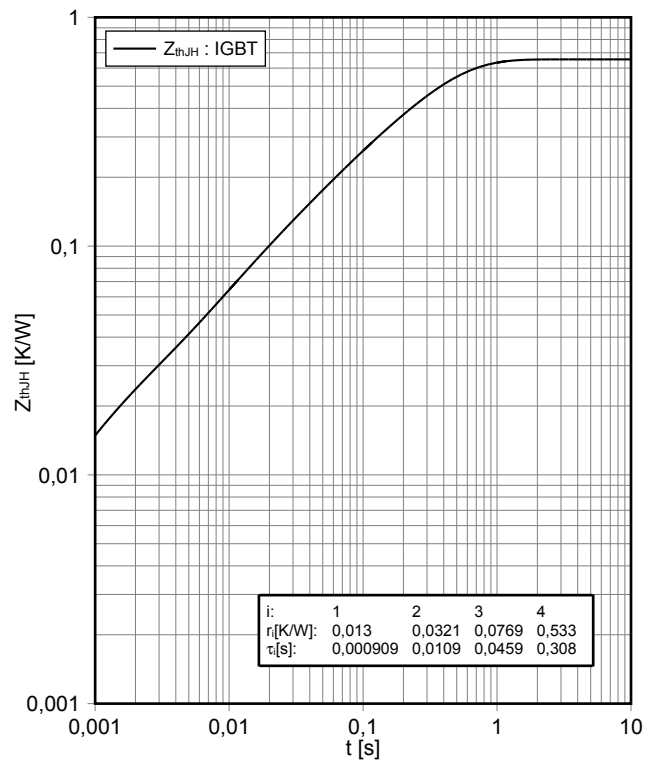
Übertragungscharakteristik IGBT,3-Level (typisch) transfer characteristic IGBT,3-Level (typical)

$I_C = f(V_{GE})$
 $V_{CE} = 20\text{ V}$



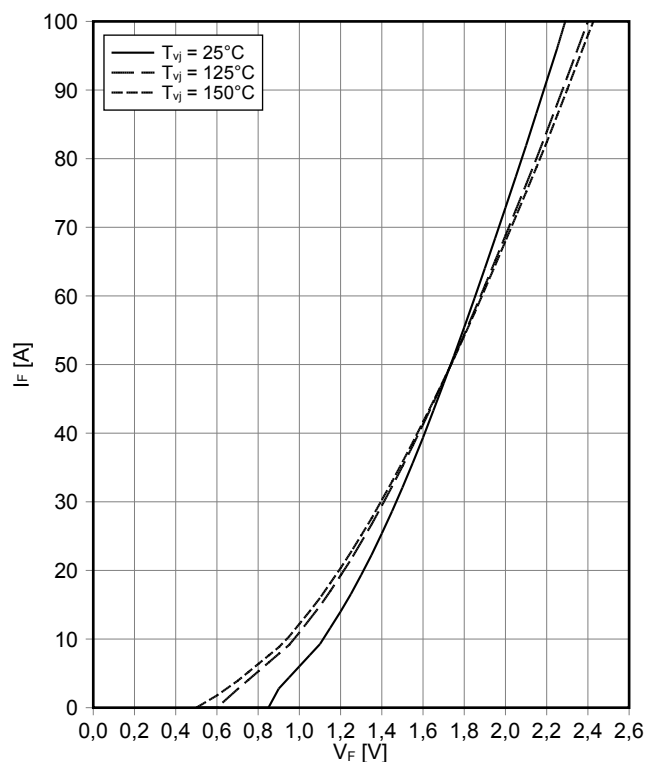
Transienter Wärmewiderstand IGBT,3-Level transient thermal impedance IGBT,3-Level

$Z_{thJH} = f(t)$



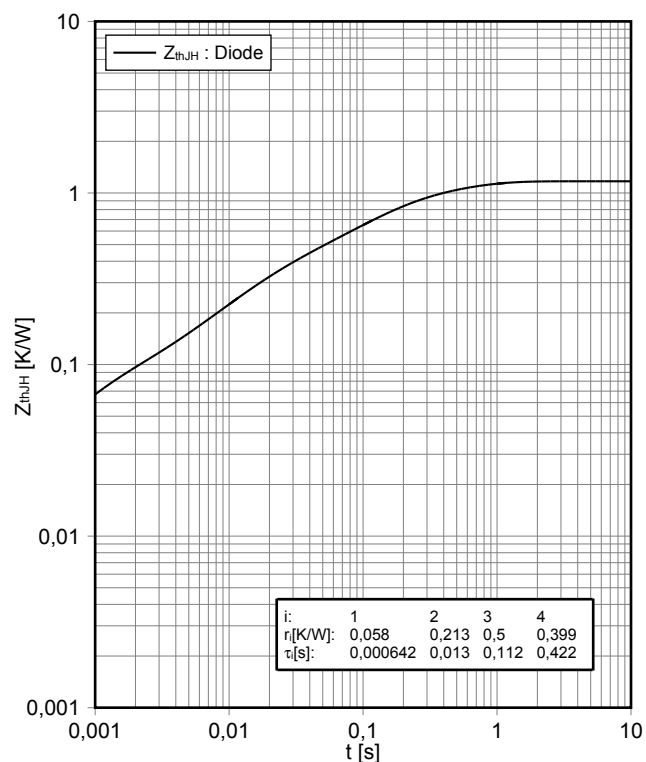
Durchlasskennlinie der Diode, 3-Level (typisch) forward characteristic of Diode, 3-Level (typical)

$I_F = f(V_F)$

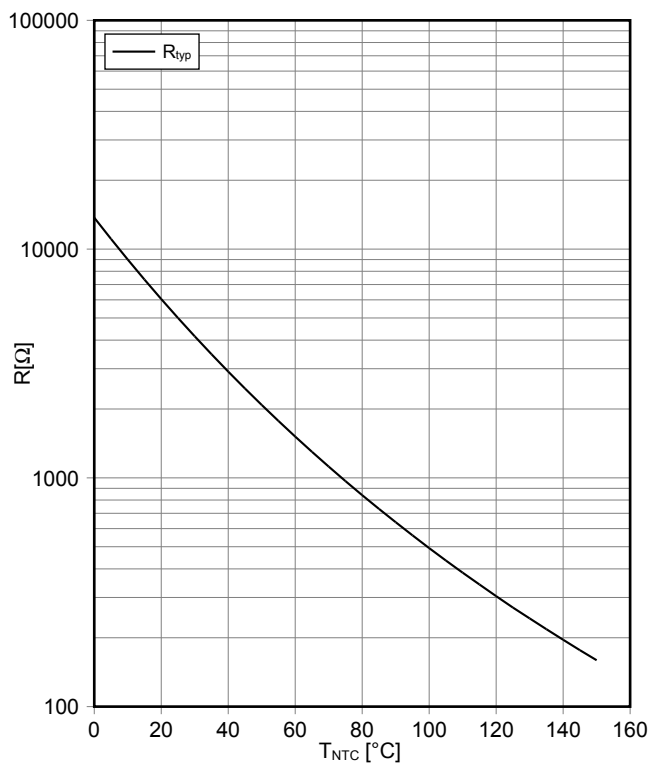


Transienter Wärmewiderstand Diode, 3-Level transient thermal impedance Diode, 3-Level

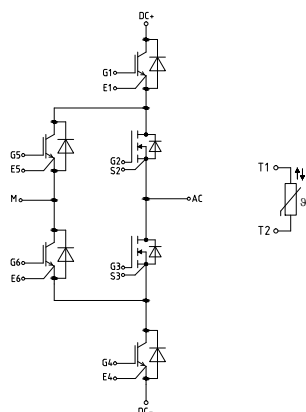
$Z_{thJH} = f(t)$



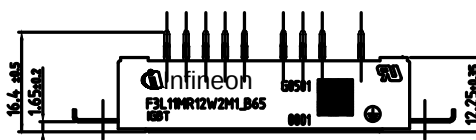
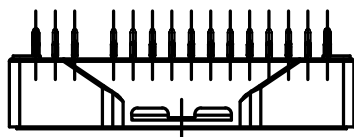
NTC-Widerstand-Temperaturkennlinie (typisch)
NTC-Thermistor-temperature characteristic (typical)
 $R = f(T)$



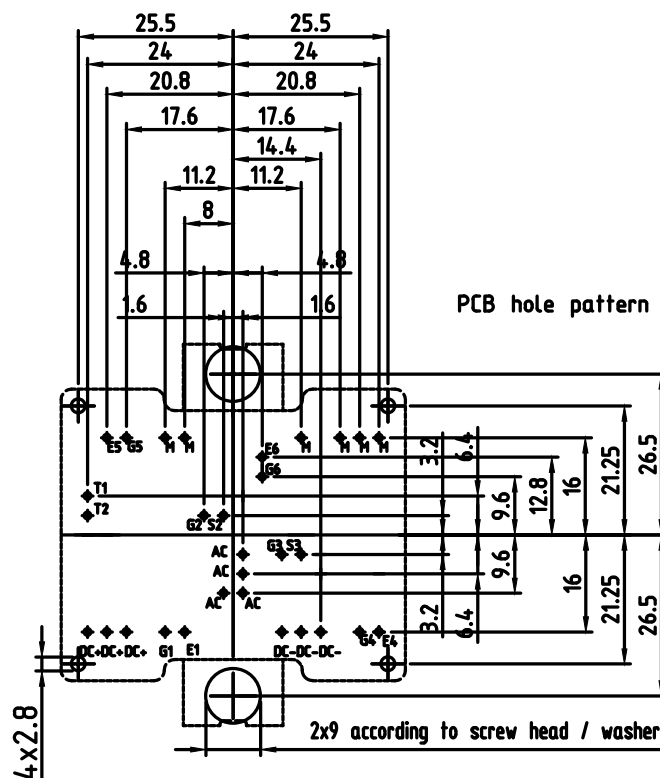
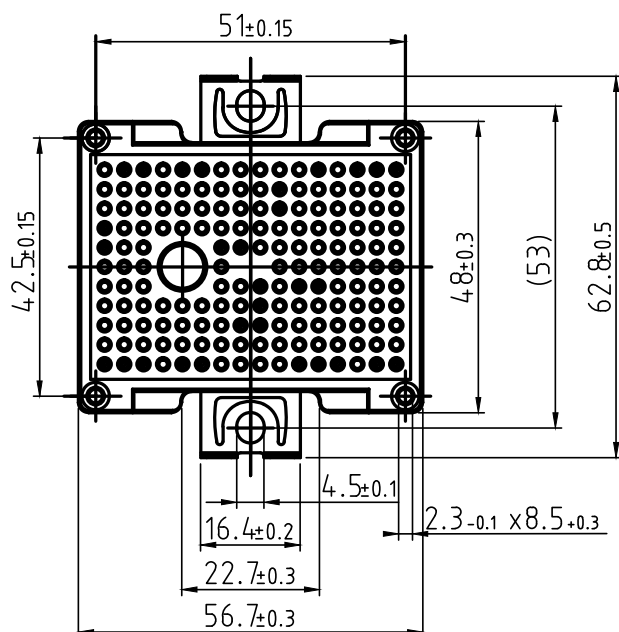
Schaltplan / Circuit diagram



Gehäuseabmessungen / Package outlines



- Pin-Grid 3.2mm
 - Tolerance of PCB hole pattern 
 - Hole specification for contacts see AN 2009-01:
- Diameters of drill $\varnothing$ 1.15mm
and copper thickness in hole 25-50 μ m



Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2018-12-12

**Published by
Infineon Technologies AG
81726 München, Germany**

**© 2018 Infineon Technologies AG.
All Rights Reserved.**

**Do you have a question about this document?
Email: erratum@infineon.com**

WICHTIGER HINWEIS

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keinesfalls Garantien für die Beschaffenheit oder Eigenschaften des Produktes ("Beschaffenheitsgarantie") dar. Für Beispiele, Hinweise oder typische Werte, die in diesem Dokument enthalten sind, und/oder Angaben, die sich auf die Anwendung des Produktes beziehen, ist jegliche Gewährleistung und Haftung von Infineon Technologies ausgeschlossen, einschließlich, ohne hierauf beschränkt zu sein, die Gewähr dafür, dass kein geistiges Eigentum Dritter verletzt ist.

Des Weiteren stehen sämtliche, in diesem Dokument enthaltenen Informationen, unter dem Vorbehalt der Einhaltung der in diesem Dokument festgelegten Verpflichtungen des Kunden sowie aller im Hinblick auf das Produkt des Kunden sowie die Nutzung des Infineon Produktes in den Anwendungen des Kunden anwendbaren gesetzlichen Anforderungen, Normen und Standards durch den Kunden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Eignung dieses Produktes für die beabsichtigte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Produktdaten für diese Anwendung obliegt den technischen Fachabteilungen des Kunden.

Sollten Sie von uns weitere Informationen im Zusammenhang mit dem Produkt, der Technologie, Lieferbedingungen bzw. Preisen benötigen, wenden Sie sich bitte an das nächste Vertriebsbüro von Infineon Technologies (www.infineon.com).

WARNHINWEIS

Aufgrund der technischen Anforderungen können Produkte gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Fragen zu den in diesem Produkt enthaltenen Substanzen, setzen Sie sich bitte mit dem nächsten Vertriebsbüro von Infineon Technologies in Verbindung.

Sofern Infineon Technologies nicht ausdrücklich in einem schriftlichen, von vertretungsberechtigten Infineon Mitarbeitern unterzeichneten Dokument zugestimmt hat, dürfen Produkte von Infineon Technologies nicht in Anwendungen eingesetzt werden, in welchen vernünftigerweise erwartet werden kann, dass ein Fehler des Produktes oder die Folgen der Nutzung des Produktes zu Personenverletzungen führen.

IMPORTANT NOTICE

The information given in this document shall in no event be regarded as a guarantee of conditions or characteristics ("Beschaffenheitsgarantie"). With respect to any examples, hints or any typical values stated herein and/or any information regarding the application of the product, Infineon Technologies hereby disclaims any and all warranties and liabilities of any kind, including without limitation warranties of non-infringement of intellectual property rights of any third party.

In addition, any information given in this document is subject to customer's compliance with its obligations stated in this document and any applicable legal requirements, norms and standards concerning customer's products and any use of the product of Infineon Technologies in customer's applications.

The data contained in this document is exclusively intended for technically trained staff. It is the responsibility of customer's technical departments to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product information given in this document with respect to such application.

For further information on the product, technology, delivery terms and conditions and prices please contact your nearest Infineon Technologies office (www.infineon.com).

WARNINGS

Due to technical requirements products may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact your nearest Infineon Technologies office.

Except as otherwise explicitly approved by Infineon Technologies in a written document signed by authorized representatives of Infineon Technologies, Infineon Technologies' products may not be used in any applications where a failure of the product or any consequences of the use thereof can reasonably be expected to result in personal injury.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.